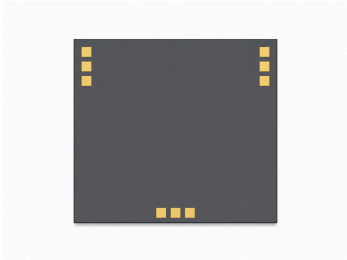


2000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.



RF-Kennwerte · TA = +25 °C

| Parameter        | Symbol | Minimum | Typisch | Maximum | Wert       | Einheit |
|------------------|--------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Betriebsfrequenz | -      | 2000    | -       | 18000   | 2000–18000 | MHz     |
| Isolation        | -      | -       | 20      | -       | -          | dB      |
| Eingangs-VSWR    | -      | -       | 1.3     | -       | -          | -       |
| Ausgangs-VSWR    | -      | -       | 1.3     | -       | -          | -       |

Grenzwerte

| Parameter                 | Symbol | Minimum | Typisch | Maximum | Einheit |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Maximale Eingangsleistung | -      | -       | -       | 30      | dBm     |

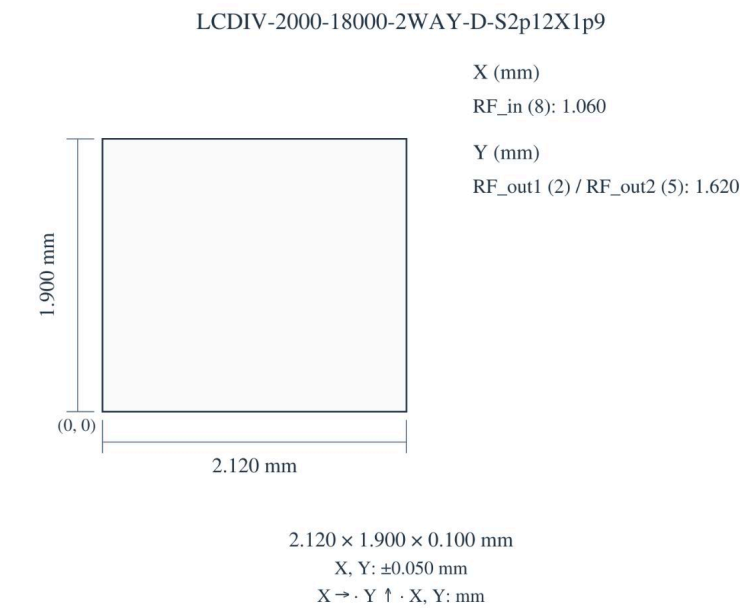
Umgebungsbedingungen

| Parameter          | Symbol | Minimum | Typisch | Maximum | Einheit |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Lagertemperatur    | -      | -65     | -       | 150     | °C      |
| Betriebstemperatur | -      | -55     | -       | 85      | °C      |

Chipabmessungen

| Parameter       | Wert             | Einheit |
|-----------------|------------------|---------|
| Chipabmessungen | 2.12 × 1.9 × 0.1 | mm      |

Mechanische Maßzeichnung



Alle Maße in mm [in].

Bondpad-Belegung

| Anschlüsse       | Symbol | Funktion                           | Hinweise |
|------------------|--------|------------------------------------|----------|
| 1, 3, 4, 6, 7, 9 | GND    | Masse; kein Bonddraht erforderlich | -        |
| 2                | RFout1 | RF-Ausgang                         | 1        |
| 5                | RFout2 | RF-Ausgang                         | 2        |
| 8                | RFin   | RF-Eingang                         | -        |

Aktueller Publikationsstand · 1.3 · 2026-10-27. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.2.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

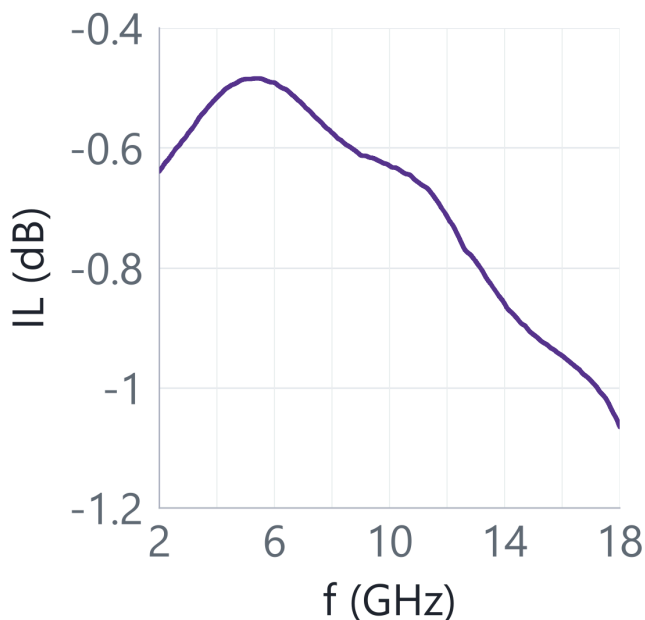
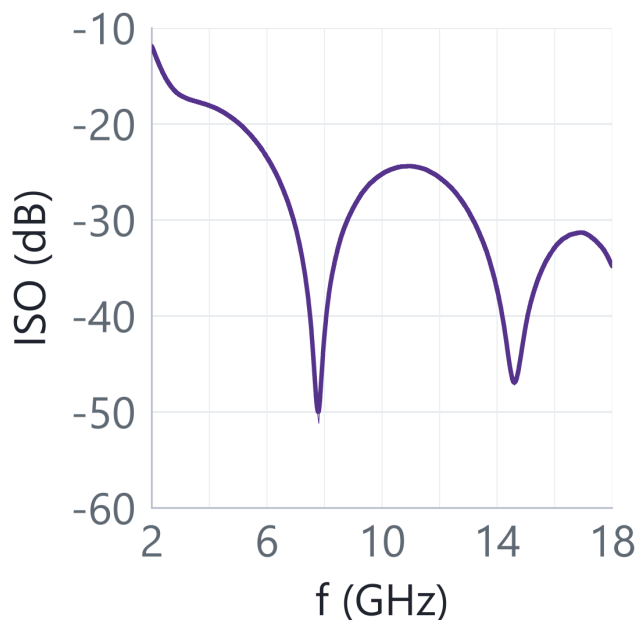
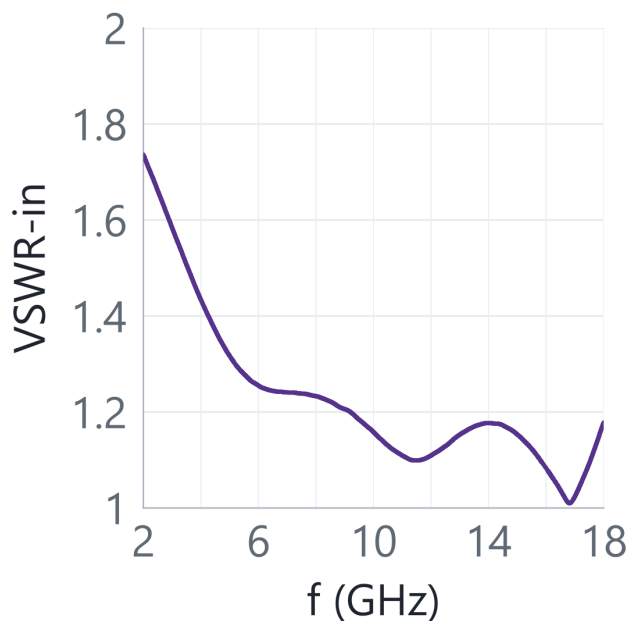
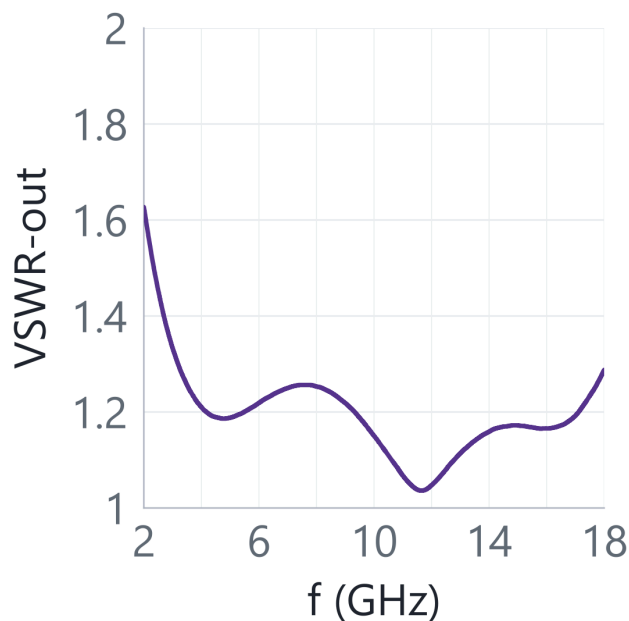
Maßskizze nach Quelldokumentation in mm. Teilinformationen; keine vollständige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.

## Kennlinien

Diagramme aus dem ursprünglichen Datenblatt. Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

### Einfügedämpfung; Isolation; Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung.

Nach der Originalgrafik neu gezeichnet; die ablesbaren Werte sind Näherungswerte.



[Quelle](#)

## Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.